シングルサイクルアクセス可能な二階層キャッシュアーキテクチャ

山口誠一朗† 石原 亨†† 安浦 寛人†††

あらまし 組込みプロセッサのメモリサブシステムの消費エネルギーを削減するために、プロセッサコアとL1キャッ シュメモリ(以下,キャッシュメモリを単にキャッシュという)の間に小容量のL0キャッシュを配置する技術が広く利 用されている.L0キャッシュは小容量であるためキャッシュヒットすれば消費エネルギーを削減できる.しかし、キャッ シュミスした場合,L1キャッシュへアクセスするために最低1サイクル必要となり、プロセッサの性能低下を引き 起こす.この問題を解決するため、シングルサイクルアクセス可能な二階層キャッシュ(STC: Single-cycle-accessible Two-level Cache)アーキテクチャを本稿で提案する.STCアーキテクチャでは、プロセッサコアはシングルサイク ルで小容量キャッシュまたはL1キャッシュにアクセスできる.さらに、STCアーキテクチャを有効活用するコンパイ ル技術も本稿で提案する.ベンチマークを用いた実験では、L0キャッシュを用いたアプローチと比較して、メモリサ プシステムの消費エネルギーを最大で 64%、平均で 41%削減できた.

キーワード 組込みシステム,キャッシュメモリ,消費エネルギー

Single-Cycle-Accessible Two-Level Cache Architecture

Seiichiro YAMAGUCHI[†], Tohru ISHIHARA^{††}, and Hiroto YASUURA^{†††}

† Graduate School of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University †† System LSI Research Center, Kyushu University ††† Kyushu University

Abstract A small L0-cache located between an MPU core and an L1-cache is widely used in embedded processors for reducing the energy consumption of memory subsystems. Since the L0-cache is small, if there is a hit, the energy consumption will be reduced. On the other hand, if there is a miss, at least one extra cycle is needed to access the L1-cache. This degrades the processor performance. Single-cycle-accessible Two-level Cache (STC) architecture proposed in this paper can resolve the problem in the conventional L0-cache based approach. Both a small L0 and a large L1 caches in our STC architecture can be accessed from an MPU core within a single cycle. A compilation technique for effectively utilizing the STC architecture is also presented in this paper. Experiments using several benchmark programs demonstrate that our approach reduces the energy consumption of memory subsystems by 64% in the best case and by 41% on an average without any performance degradation compared to the conventional L0-cache based approach.

Key words Embedded system, cache memory, energy consumption

1. はじめに

携帯電話に代表されるバッテリー駆動の組込みシステムのみ ならず、あらゆる組込みシステムにおいて消費エネルギーの削 減は重要な課題である.また、多くの機能を一つのシステムで 実現するために、組込みシステム向けプロセッサの性能向上も 求められている.これらの要求を満たすためにキャッシュメモ リ (以下, キャッシュという) がプロセッサには搭載されてい る. キャッシュを利用することで, 大容量であるがアクセス時 間が遅く, アクセスエネルギーが大きいオフチップメモリへの アクセス回数を削減している. しかし, キャッシュで消費され るエネルギーはプロセッサで消費されるエネルギーの 40%以上 を占めている [1], [2]. したがって, キャッシュ, さらにはオフ チップメモリを含めたメモリサブシステムで消費されるエネル



図1 L0 キャッシュを搭載したメモリサブシステムの構成.

→ L1-cache ←		Address space
MPU core	Off-chip memory	Cache region
MPU SPM		SPM region

図 2 SPM を搭載したメモリサブシステムの構成およびアドレス空間 の割当て.

ギーを削減することは重要である.

我々は文献[3]で、メモリサブシステムで消費されるエネル ギーを削減するためのキャッシュアーキテクチャ、シングルサ イクルアクセス可能な二階層キャッシュ(STC: Single-cycleaccessible Two-level Cache)アーキテクチャを提案している. STC アーキテクチャは、小容量のキャッシュと通常サイズの キャッシュを二階層キャッシュとして搭載しながら、ともにシ ングルサイクルでアクセス可能なアーキテクチャである。アク セスエネルギーが小さい小容量のキャッシュへアクセスが集中 すれば消費エネルギーを削減できる。本稿では、STC アーキテ クチャについて説明し、それを有効活用するためのコード配置 技術を提案する。これにより、小容量キャッシュへのアクセス を集中させ、結果としてメモリサブシステムの消費エネルギー 削減を達成する.

2. 関連研究

2.1 L0 キャッシュ

L0キャッシュと呼ばれる小容量キャッシュをプロセッサコア とL1キャッシュの間のメモリ階層に搭載する技術が多く提案 されている[4]~[8]. L0キャッシュを搭載したメモリサブシス テムの構成を図1に示す. L0キャッシュは小容量であるため, アクセス当たりのエネルギーはL1キャッシュよりも小さい. し たがって, L0キャッシュヒットすれば, アクセスエネルギーを 削減できる. 一方で, L0キャッシュミスすれば, L1キャッシュ ヘアクセスするために少なくとも1サイクル必要となり, プロ セッサの性能低下を引き起こす要因となる. L0キャッシュを用 いたメモリサブシステムでは,メモリアクセスの時間的局所性 が高い場合にアクセスエネルギーの削減効果は大きい.

2.2 スクラッチパッドメモリ

L0 キャッシュを搭載したメモリサブシステムの問題点を解 決する一つの方法として,ソフトウェア制御可能なスクラッチ パッドメモリ (SPM: Scratch-Pad Memory)をL1 キャッシュ と共に活用する方法がある. SPM を搭載したメモリサブシス テムの構成およびアドレス空間の割当てを図2に示す. SPM とL1 キャッシュは同じメモリ階層にあるため,プロセッサコ アはどちらのメモリへもシングルサイクルでアクセス可能であ る. アクセスアドレスの一部のビットからアドレス空間の領域

Main-cache	Address space
MPU core Mini- Off-chip	Main-cache region
MPU cache	Mini-cache region

図 3 HPC アーキテクチャのメモリサブシステムの構成およびアドレ ス空間の創当て.



図 4 STC アーキテクチャのメモリサブシステムの構成およびアドレ ス空間の創当て.

を判定し,その結果により SPM とL1 キャッシュのどちらか片 方のみがアクセスされる.アドレス空間の SPM 領域は静的に SPM に割り当てられており,SPM 領域のコード/データはシ ステム起動時に SPM ヘコピーされる.つまり,SPM は割り当 てられたアドレスのコード/データを常に保持しており,アク セスミスは発生しない.また,SPM はキャッシュに必要不可欠 なタグの読出し/比較を行う必要がないため,アクセスエネル ギーが小さい.したがって,プログラマやコンパイラが SPM 領域に適切なコード/データを配置できればエネルギーの削減 が見込める.コード/データの配置に関する研究は文献[9]~ [12] などで行われている.さらには,SPM をオーバーレイす る技術についても研究されている [13]~[16].

2.3 Horizontally Partitioned Cache

Horizontally Partitioned Cache (HPC) アーキテクチャは 同じメモリ階層に小容量のキャッシュ (Mini キャッシュ) と通常 サイズのキャッシュ (Main キャッシュ)を持つ[17]~[19]. HPC アーキテクチャのメモリサブシステムの構成およびアドレス空 間の割当てを図3に示す.アドレス空間は二つの領域, Main キャッシュ領域および Mini キャッシュ領域に分割されており, それぞれのキャッシュに割り当てられている. SPM を搭載した メモリサブシステムと同様に、アクセスアドレスの一部のビッ トからアドレス空間の領域を判定し、その結果によりどちらか 片方のキャッシュのみがアクセスされる. SPM を搭載したメモ リサブシステムとの違いは、異なるアドレスのコード/データ を Mini キャッシュは自動的に保持することができる点である.

3. STC アーキテクチャ

STC アーキテクチャは小容量のキャッシュ (Small キャッシュ) と通常サイズのキャッシュ (Main キャッシュ)を二階層のキャッ シュとして搭載しながら,ともにシングルサイクルでアクセ ス可能なアーキテクチャである.STC アーキテクチャのメモ リサプシステムの構成およびアドレス空間の割当てを図4に 示す.STC アーキテクチャでは,HPC アーキテクチャと同様 にアドレス空間は二つの領域,Single キャッシュ領域および Multi キャッシュ領域に分割されている.STC アーキテクチャ と HPC アーキテクチャの違いは,Multi キャッシュ領域の割



図 5 2 行×2 列の SRAM アレイ.

当てである. Single キャッシュ領域に存在するコード/データ は全て Main キャッシュを介してアクセスされる. これは HPC アーキテクチャにおいて, Main キャッシュ領域に存在するコー ド/データは全て Main キャッシュを介してアクセスされるこ とと同じ動作である. 一方, Multi キャッシュ領域に存在する コード/データをオフチップメモリからコピーする際は、優先 的に Small キャッシュを上書き(データが更新されている場合 は書き戻し操作も必要)する. STC アーキテクチャでは、こ のとき上書き(書き戻し)される対象である低優先度のライン を Main キャッシュに退避させる. 退避先である Main キャッ シュの低優先度のラインは Main キャッシュから追い出される. つまり, Multi キャッシュ領域は Main キャッシュおよび Small キャッシュの両方に割り当てられている.

SPM を搭載したメモリサブシステムや HPC アーキテクチャ のメモリサブシステムと同様に、STC アーキテクチャのメモ リサブシステムでもアクセスされるのはどちらか片方のメモリ のみである. SPM 搭載および HPC アーキテクチャのメモリ サブシステムの場合、アクセスアドレスの一部のビットからア ドレス空間の領域を判定し、その領域に割り当てられた唯一の メモリをアクセスすればよい.STC アーキテクチャのメモリ サブシステム場合、判定された領域が Single キャッシュ領域の 場合に限りアクセスすべきメモリが Main キャッシュであると 一意に決まる.一方,判定された領域が Multi キャッシュ領域 の場合はどちらのキャッシュにコード/データがある(もしく はどちらにもない)かわからない.まず Small キャッシュヘア クセスし、ミスした場合に Main キャッシュをアクセスする方 法と取れば、L0 キャッシュを搭載したメモリサブシステムと同 様にプロセッサの性能低下を引き起こす. 両キャッシュへ同時 にアクセスすれば、プロセッサの性能低下は発生しないが無駄 なエネルギーを消費することにつながる. STC アーキテクチャ では、Small キャッシュのタグを SRAM アレイではなく D 型 フリップフロップ (FF) アレイを用いて構成することにより, データフィールドヘアクセスする前に Small キャッシュのヒッ ト/ミスを判定し、この問題を解決する.

図5および図6に2行×2列の一般的なSRAMアレイおよびFFアレイを示す. SRAMアレイが保持している値は通常



図 6 2 行×2 列の FF アレイ.

以下のような手順で読み出す.

(1) アクセスアドレスのインデックスをデコードし,活性 化させるワードラインを決定する.デコードと同時にビットラ インをプリチャージする.

(2) Enable 信号によりワードラインを活性化させる.

(3) センスアンプ回路を用いて, データを読み出す.

セット・アソシアティブ・キャッシュからコード/データを 読み出す場合はさらに上記手順に加え,アクセスアドレスのタ グと SRAM アレイから読み出したタグの値を比較し,ヒット /ミス判定を行う.ヒットした場合は,タグの読み出しと同時 に読み出していた全てのウェイのデータフィールドの値のうち ヒットしたウェイの値をプロセッサコアへ渡す.SRAM アレイ で構成されるキャッシュではこれらの動作が通常1サイクルで 行われている.一方,FFが保持している値はSRAM セルとは 異なり常にアクセス可能である.SRAM アレイの読み出し手 順(2)のワードライン活性化よりも先に Small キャッシュの ヒット/ミス情報がわかれば,どちらのキャッシュへアクセス すべきかが決定する.

FF アレイを用いた時のヒット/ミス情報の判定に要する時 間は、マルチプレクサおよびタグ比較器の遅延時間を足し合 わせたものに等しい. Multi キャッシュ領域のサイズを Small キャッシュのサイズの N 倍とすると、 [log2(N)] ビットのタグ メモリを実装する必要がある. Multi キャッシュ領域のサイズを 4MB, Small キャッシュのサイズを 1KB, ラインサイズを 32B と仮定すると、12 ビット×32 ライン分のタグメモリが必要で ある. 商用の 65nm CMOS プロセスを用いてこのタグメモリ 用のマルチプレクサおよびタグ比較器を設計し遅延時間を見積 もった結果、それぞれ約 550 ps、約 420 ps であった. SRAM アレイの読み出し手順(2) がシングルサイクルの半分のタイミ ングで実行されるとすると、動作周波数が 500 MHz 以下の組 込みプロセッサにおいてはキャッシュのワードラインを活性化 させる前に Small キャッシュのヒット/ミスを判定可能である.

図7に2ウェイ・セット・アソシアティブの Small キャッシュ を示す. Region タグはアドレス空間のどちらの領域に含まれる かを判定するために使用される. Small タグは Small キャッシュ におけるタグである. Region タグおよび Small タグを並べた



図7 2ウェイ・セット・アソシアティブ Small キャッシュ.



ものが Main キャッシュ用のタグ (Main タグ) である. Small キャッシュのヒット/ミス判定は, Region タグを用いた領域判 定と同時に行われる.

4. コードおよびデータ配置

4.1 コンパイラフレームワーク

メモリサブシステムの消費エネルギーはコードおよびデータ 配置に強く依存しているため、メモリサブシステムの消費エネ ルギー最適化問題は、メモリオブジェクトの配置問題と捉える ことができる.STCアーキテクチャを有効活用するためのコ ンパイラフレームワークを図8に示す。ターゲットアプリケー ションをコンパイルし、実行ファイルおよび初期配置アドレス が決まったメモリオブジェクトのリストを得る。デバッガを用 いることでアドレストレースを取得する。最適なコードおよび データ配置を求めるために、メモリオブジェクトリスト、アド レストレースおよびいくつかの制約条件をマッピングフレーム ワークに入力する。マッピングフレームワーク中のシミュレー タは次節で示すエネルギーモデルおよびタイミングモデルを使 用して消費エネルギーおよび実行サイクル数を見積もる。コー ド配置のアルゴリズムは次々節で説明する。

4.2 エネルギーおよびタイミングモデル

メモリサブシステムの消費エネルギー *E*total およびターゲットアプリケーションの実行時間 *T*total は以下のような式で表す

Code_and_Data_Placement
Input:
$$TR, F, t_{const}$$

Output: F'
 $E_{min} = infinity;$
repeat
for $(t = 0; t < |F|; t + +)$ do
 $o = F[t];$
tentatively place memory object o to the multi-cache
region;
 $TR' = modified TR$ according to the relocation of o ;
Calculate $E_{tmp} = Energy(TR');$
Calculate $t_{tmp} = time(TR');$
if $(E_{tmp} \leq E_{min} \text{ and } t_{tmp} \leq t_{const})$
 $E_{min} = E_{tmp};$
 $o_{best} = o;$
end if
end for
Remove o_{best} from F ;
Append o_{best} into F' ;
Update TR according to F and F' ;
until E_{min} stops decreasing
Output F'

図 9 コードおよびデータ配置アルゴリズム.

$$E_{total} = N_{RStag} \cdot E_{RStag} + N_{RSdata} \cdot E_{RSdata}$$

$$+ N_{RM} \cdot E_{RM} + N_{Roff} \cdot E_{Roff}$$

$$+ N_{WStag} \cdot E_{WStag} + N_{WSdata} \cdot E_{WSdata}$$

$$+ N_{WM} \cdot E_{WM} + N_{Woff} \cdot E_{Woff} \qquad (1)$$

$$T_{total} = N_{PSdata} \cdot T_{RSdata} + N_{PM} \cdot T_{PM}$$

$$+N_{Roff} \cdot T_{Roff} + N_{WSdata} \cdot T_{WSdata} + N_{WM} \cdot T_{WM} + N_{Woff} \cdot T_{Woff}$$
(2)

ここで、 E_{RStag} , E_{RSdata} , E_{RM} , E_{Roff} , E_{WStag} , E_{WSdata} , E_{WM} および E_{Woff} はそれぞれ、Small キャッシュのタグ読み 出し、Small キャッシュのデータ読み出し、Mail キャッシュの 読み出し、オフチップメモリの読み出し、Small キャッシュの グ書き込み、Small キャッシュのデータ書き込み、Main キャッ シュの書き込みおよびオフチップメモリの書き込みの操作に関 する消費エネルギーを表している. N_{RStag} , N_{RSdata} , N_{RM} , N_{Roff} , N_{WStag} , N_{WSdata} , N_{WM} および N_{Woff} は各操作の 実行回数を表す. T_{RSdata} , T_{RM} , T_{Roff} , T_{WSdata} , T_{WM} 着 よび T_{Woff} は各操作の実行時間を表している. 変数 N_x の値は マッピングフレームワーク中のシミュレータにアドレストレー スを入力し求める. 変数 E_x および T_x の値は各メモリモジュー ルの値を用いる.

4.3 アルゴリズム

図9に示すアルゴリズムの入力は、メモリオブジェクトリス ト F である.メモリオブジェクトには関数、グローバル変数、 および定数が含まれる.アプリケーションプログラムのアドレ ストレース TR もまたアルゴリズムの入力である.実行時間制 約 t_{const} は問題の制約として与えられる.メモリサブシステム の消費エネルギーおよびターゲットアプリケーションの実行時 間は TR および前節で示したエネルギーモデルおよびタイミン グモデルを用いて見積もる.アルゴリズムのメインループは全 てのメモリオブジェクトが Single キャッシュ領域に配置された 状態で始まる.そして,Multi キャッシュ領域に配置すべきメ モリオブジェクトの最適なセット F'が見つかる.この操作は 一つのメモリオブジェクト。を Fの先頭から一つ選び, o を Multi キャッシュ領域へ配置したときのエネルギー削減量を計 算することで行われる.この計算は Fの全てのメモリオブジェ クトに対して行われる.全てのメモリオブジェクトに対して計 算を行ったのち,最もエネルギーが削減されたメモリオブジェ クト o_{best} を F から F' へ移動させる.この操作をエネルギー が削減されなくなるまで続ける.最終的にアルゴリズムは最適 な F'を出力する.

5. 実験結果

我々は実験に EEMBC DENBench 1.0 [20] をベンチマーク として利用した.利用したベンチマークを表1に示す.東芝 MeP アーキテクチャ用の GNU C コンパイラおよびデバッガ をメモリオブジェクトリストの作成およびアドレストレースの 作成に使用した. 各シングルタスクベンチマークのアドレス トレースの長さは、最初の 100 万命令をスキップしたあとの 1000 万命令とした、表1 に示したアクティブコードサイズとは アドレストレース中に現れるコードサイズのことである. 我々 は実験でオリジナルのアドレストレース tasksetA. tasksetB および tasksetC をシングルタスクアプリケーションのアドレ ストレースを複数混成して作成した. 例えば tasksetA は aes, cjpeg, des, djpeg および huffde からなる. tasksetA では. 各シングルタスクのアプリケーションが 100 万命令ごとに切 り替わりながら実行されていくことを仮定した. tasksetA で huffde が実行されたあとは aes の続きに戻る. これらマルチ タスクを模擬したアドレストレースの長さは最初の 500 万命令 をスキップしたあとの 3000 万命令とした.

我々は図 8 に示したコードおよびデータのマッピングフレー ムワークを開発した.コードおよびデータ配置アルゴリズムも 開発したフレームワークに実装している.実行時間の制約は L0 キャッシュを搭載したメモリサブシステムの実行時間と設定し た.各メモリモジュールの消費エネルギーモデルおよび実行時間 は商用の 65nm CMOS テクノロジを用いて見積もった値を使用 した.また,オフチップメモリとして Micron mobile SDRAM MT48H16M32LFCM-75 IT [21] のモデルを使用した.実験で は表 2 に示すオンチップメモリのコンフィグレーションを想定 した.実験で想定するメモリサブシステムは命令に関するメモ リサブシステムとし,8 バイトの命令バッファを持つと仮定し た.HPC アーキテクチャにおける Mini キャッシュ領域および STC アーキテクチャにおける Multi キャッシュ領域のサイズは 4MB と仮定した.

図 10 に関連研究および STC アーキテクチャのメモリサブシ ステムの消費エネルギーの結果を示す. 消費エネルギーの値は

表 2	オンチップメモリのコン	ノフィグレーション
-----	-------------	-----------

On-chip Memory	Configurations
L1-cache	4way 8KB or 2way 8KB or 2way 4KB
Main-cache	line size:32byte
L0-cache, Mini-cache	2way 1KB or Direct map 1KB
Small-cache	or Direct map 512B, line size:32byte
SPM	1KB or 512B



L0 キャッシュを搭載したメモリサブシステムの消費エネルギー で正規化している. HPC および STC アーキテクチャのメモリ サブシステムでは二種類の領域を使いこなしエネルギーを削減 できている. これら HPC および STC アーキテクチャに対し ては開発したフレームワークを使用してコード配置を行った. また、SPM に関しては最も実行回数が多い関数から順に SPM 領域へ割り当てていき, SPM 領域に配置するコードがなくな る順に割当てを行った. STC アーキテクチャでは. L0 キャッ シュ搭載のメモリサブシステムと比較して性能のオーバーヘッ ドなく最大で約 64%, 平均して約 41%の消費エネルギーを削 減できている.図10からわかるように多くのシングルタスク のアプリケーションでは SPM を搭載したメモリサブシステム が最もよい結果を示している. この原因は各ベンチマークのア クティブコードサイズが小さいことに起因していると考えられ る. 一方で、STC アーキテクチャはマルチタスクを模擬したべ ンチマークにおいて効果がある.

6. おわりに

本稿では、シングルサイクルアクセス可能な二階層キャッシュ (STC) アーキテクチャ、および STC アーキテクチャを有効活 用するためのコンパイラフレームワークを提案した。EEMBC DENBench 1.0 ベンチマークを使用した実験では、STC アー キテクチャのメモリサブシステムの消費エネルギーは L0 キャッ シュ搭載のメモリサブシステムと比較して性能低下なく最大で 約 64%、平均して約 41%の消費エネルギーを削減できた。

謝辞 本研究は東京大学大規模集積システム設計教育研究センターを通し,株式会社半導体理工学研究センター,(株)イー・シャトルおよび富士通株式会社の協力で行われたものである. 本研究の一部は,科学技術振興事業団(JST)の戦略的創造研 究推進事業(CREST)「情報システムの超低消費電力化を目指 した技術革新と総合化技術」の支援によるものである.

Benchmarks	Description	Code size	Active code size
aes	AES	55.10 KB	3.47 KB
cjpeg	JPEG Compression	71.34 KB	10.53 KB
des	DES	56.76 KB	7.91 KB
djpeg	JPEG Decompression	75.95 KB	6.50 KB
huffde	Huffman Decoder	49.23 KB	0.88 KB
mpeg2dec	MPEG-2 Decoder	84.76 KB	9.66 KB
mpeg2enc	MPEG-2 Encoder	112.30 KB	33.38 KB
mp3player	MP3 Player	64.64 KB	7.31 KB
mpeg4dec	MPEG-4 Decoder	256.05 KB	27.47 KB
rgbcmyk	RGB to CMYK Converter	49.18 KB	2.03 KB
rgbhpg	High-Pass Gray-Scale Filter	49.45 KB	2.19 KB
rgbyiq	RGB to YIQ Converter	49.38 KB	2.09 KB
rsa	RSA	100.23 KB	10.91 KB
tasksetA	aes, cjpeg, des, djpeg, huffde	308.38 KB	27.34 KB
tasksetB	mpeg2dec, mp3player, rgbcmyk, rgbhpg	248.02 KB	21.19 KB
tasksetC	mpeg2enc, mpeg4dec, rgbyiq, rsa	517.96 KB	62.66 KB

表 1 ベンチマークアプリケーション

文 献

- S. Segars, "Low-power design techniques for microprocessor," International Solid-State Circuits Conference Tutorial, Feb. 2001.
- [2] J. Montanaro et al., "A 160-MHz, 32-b, 0.5-W CMOS RISC microprocessor," *IEEE Journal of Solid-State Cir*cuits, vol. 31, no. 11, pp. 1703–1714, Nov. 1996.
- [3] S. Yamaguchi, T. Ishihara, and H. Yasuura, "A single cycle accessible two-level cache architecture for reducing the energy consumption of embedded systems," in *Proc. of International SoC Design Conference*, pp. 188–191, Nov. 2008.
- [4] C.-L. Su and A. M. Despain, "Cache design trade-offs for power and performance optimization: A case study," in *Proc. of International Symposium on Low Power Design*, pp. 63–68, Apr. 1995.
- [5] M. B. Kamble and K. Ghose, "Analytical energy dissipation models for low power caches," in *Proc. of International Symposium on Low Power Electronics and Design*, pp. 143– 148, Aug. 1997.
- [6] N. Bellas, I. Hajj, C. Polychronopoulos, and G. Stamoulis, "Architectural and compiler support for energy reduction in the memory hierarchy of high performance microprocessors," in *Proc. of International Symposium on Low Power Electronics and Design*, pp. 70–75, Aug. 1998.
- [7] J. Kin, M. Gupta, and W. H. Mangione-Smith, "The filter cache: An energy efficient memory structure," in *Proc. of International Symposium on Microarchitecture*, pp. 184– 193, Dec. 1997.
- [8] R. Panwar and D. Rennels, "Reducing the frequency of tag compares for low power I-cache design," in *Proc. of International Symposium on Low Power Design*, pp. 57–62, Apr. 1995.
- [9] O. Avissar, R. Barua, and D. Stewart, "An optimal memory allocation scheme for scratch-pad-based embedded systems," ACM Trans. on Embedded Computing Systems, vol. 1, no. 1, pp. 6–26, Nov. 2002.
- [10] S. Steinke, L. Wehmeyer, B.-S. Lee, and P. Marwedel, "Assigning program and data objects to scratchpad for energy reduction," in *Proc. of Design, Automation, and Test in Europe*, pp. 409–415, Mar. 2002.
- [11] M. Verma, L. Wehmeyer, and P. Marwedel, "Cache-aware scratchpad allocation algorithm," in *Proc. of Design, Automation, and Test in Europe*, vol. 2, pp. 1264–1269, Feb. 2004.

- [12] Y. Ishitobi, T. Ishihara, and H. Yasuura, "Code placement for reducing the energy consumption of embedded processors with scratchpad and cache memories," in *Proc. of IEEE/ACM/IFIP Workshop on Embedded Systems for Real-Time Multimedia*, pp. 13–18, Oct. 2007.
- [13] P. Francesco, P. Marchal, D. Atienza, L. Benini, F. Catthoor, and J. M. Mendias, "An integrated hardware/software approach for run-time scratchpad manegement," in *Proc. of Design Automation Conference*, pp. 238– 243, Jun. 2004.
- [14] M. Kandemir, J. Ramanujam, M. J. Irwin, N. Vijaykrishnan, I. Kadayif, and A. Parikh, "Dynamic management of scratch-pad memory space," in *Proc. of Design Automation Conference*, pp. 690–695, Jun. 2001.
- [15] S. Udayakumaran, A. Dominguez, and R. Barua, "Dynamic allocation for scratch-pad memory using compile-time decisions," ACM Trans. on Embedded Computing Systems, vol. 5, no. 2, pp. 472–511, May 2006.
- [16] M. Verma, L. Wehmeyer, and P. Marwedel, "Dynamic overlay of scratchpad memory for energy minimization," in *Proc. of International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis*, pp. 104–109, Sep. 2004.
- [17] A. González, C. Aliagas, and M. Valero, "A data cache with multiple caching strategies tuned to different types of locality," in *Proc. of International Conference on Supercomputing*, pp. 338–347, Jul. 1995.
- [18] A. Shrivastava, I. Issenin, and N. Dutt, "Compilation techniques for energy reduction in horizontally partitioned cache architectures," in Proc. of International Conference on Compilers, Architecture and Synthesis for Embedded Systems, pp. 90–96, Sep. 2005.
- [19] A. Shrivastava, I. Issenin, and N. Dutt, "A compiler-in-theloop framework to explore horizontally partitioned cache architectures," in Proc. of Asia and South Pacific Design Automation Conference, pp. 328–333, Jan. 2008.
- $[20] \quad \text{EEMBC}, \ DENBench \ 1.0,$
- http://www.eembc.org/benchmark/digital_entertainment_sl.php. [21] Micron Technology, Inc., MICRON 512Mb Mobile SDRAM

: MT48H16M32LFCM-75 IT Data Sheet, http://www.micron.com/products/dram/mobilesdram/.